

3D Wirebonder

Der erste um die Ecke Drahtbonder

Programm / Ausschreibung	IWI 24/26, IWI 24/26, Basisprogramm Ausschreibung 2025	Status	laufend
Projektstart	04.03.2025	Projektende	03.09.2026
Zeitraum	2025 - 2026	Projektlaufzeit	19 Monate
Keywords			

Projektbeschreibung

Das Ziel dieses Innovationsprojekts ist es einen funktionsfähigen 3D Wirebonder für Dünndrahtapplikationen zu entwickeln. Dafür soll zusätzlich zu den bestehenden Verfahrensmöglichkeiten eine weitere Rotations- und Verkippungsachse des Bauteilhalters realisiert und alle miteinander synchronisiert werden.

Endberichtkurzfassung

Im Rahmen dieses Innovationsprojekts wurde erfolgreich ein funktionsfähiger 3D Wirebonder für Dünndrahtapplikationen entwickelt. Dafür wurde zusätzlich zu den bestehenden Verfahrensmöglichkeiten eine weitere Rotations- und Verkippungsachse des Bauteilhalters realisiert und mit den bestehenden Achsen synchronisiert. Die Funktionsfähigkeit wurde anhand eines realistischen Demonstrators erfolgreich erprobt.

Projektpartner

- F&S BONDTEC Semiconductor GmbH